

NUMBER 178298



METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

回路番号
CIRCUIT NO

AMPマーク
シリーズマーク
SERIES MARK

タブコンタクト
TAB CONTACT

リテンションレグ
RETENTION LEG

コンタクト半田付部
CONTACT TAIL

KEY TYPE X
1-178298-2,-3,-5

KEY TYPE Y
2-178298-2,-3,-5

Y	2-178298-5	△6	△4
	2-178298-3	△6	△3
	2-178298-2	△6	△2
X	1-178298-5	△6	△4
	1-178298-3	△6	△3
	1-178298-2	△6	△2
KEY TYPE	製品番号 (PART NO.)	(FINISH)	

B	REVISED(FJD0-0039-03)	TS	S.M.	25.APR '93
A	REVISED(FJD0-0114-03)	TS	S.M.	2/8 '93
O	RELEASED (FJD0-0017-93)	Y.T	S.M.	8-FEB-'93
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE

Copyright © 1993 AMP(Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.			
WIRE RANGE	INSULATION DIA	NAME	
mm²(AWG -)	mmφ	10 POS SINGLE ROW HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 3100	
MATERIAL SEE NOTE 注記参照	FINISH SEE NOTE 注記参照	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	SIZE LOC NUMBER
DR. 20-JAN-'93 Y.TANAKA	DE. 20-JAN-'93 Y.TANAKA	10mmF : ±0.3 10mmE 3mmF : ±0.4 30mmE 100mmF : ±0.5 角 度 : ±3'	A3 J C-178298
CHK. 8-FEB-'93 S.MANABE	APP. 8-FEB-'93 S.MANABE	SCALE 2-1	REV. B SHEET 1 OF 1

注 記

1. 材料:ハウジング: ガラス入り熱可塑性
ポリエステル樹脂 色:黒
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
2. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38μm MIN金めっき
3. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76μm MIN金めっき
4. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MINスズめっき
5. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土に半田めっき
6. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土にスズめっき

NOTES

1. MATERIAL:HOUSING:GLASS FILED THERMO
PLASTIC,POLYESTER, COLOR:BLACK
CONTACT:COPPER ALLOY
RETENTION LEG:COPPER ALLOY
2. FINISH(CONTACT AREA):0.38μmMIN GOLD PLATING
OVER Ni PLATING
3. FINISH(CONTACT AREA):0.76μmMIN GOLD PLATING
OVER Ni PLATING
4. FINISH(CONTACT AREA):2.0 μmMIN TIN
PLATED OVER NICKEL
5. FINISH(RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED
(CONTACT TAIL) OVER NICKEL
6. FINISH(RETENTION LEG): TIN PLATED
(CONTACT TAIL) OVER NICKEL

コネクタ外形
OUTLINE OF HEADER HOUSING

10-φ1.1
DIA1.1±0.1 10PLACES

スルーホール 2-φ3
DIA3±0.1 2PLACES

ラウンド 2-φ4MIN
ROUND DIA4MIN 2PLACES

推奨基板取付け穴寸法

PC 基板厚:1.6±0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN

PC BOARD THICKNESS:1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)